

本會與高通公司訴訟和解案
有關「台灣產業方案」各項計畫之金額及內容

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
<p>一、成立台灣營運與製造工程暨測試中心</p>	<p>(一)投資金額：約 5 億美元。 (二)招募員工 1,000 人。 (三)設立「5G 模組設計」、「毫米波測試」及「超音波指紋辨識技術開發」等 3 個卓越中心。</p>	<p>1、107 年 8 月 24 日宣布成立「台灣營運與製造工程暨測試中心」(Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan, COMET)。該中心將作為高通公司供應鏈營運、相關工程及業務發展等海外業務之核心據點，可加深與台灣半導體產業之關係。</p> <p>2、107 年 11 月 2 日宣布「台灣營運與製造工程暨測試中心」已規劃設置 3 個卓越中心，分別為「5G 模組設計」、「毫米波測試」及「超音波指紋辨識技術開發」，將促進與台灣半導體產業及廠商之緊密合作關係。</p> <p>3、108 年 3 月「台灣營運與製造工程暨測試中心」已正式營運，並在大專院校辦理徵才活動，進行相關領域的人才招募與投資。</p> <p>4、108 年 6 月 27 日在新竹科學工業園區舉行大樓興建動</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
		<p>土典禮，宣布台灣營運與製造工程暨測試中心、5G 測試實驗室、多媒體研發中心及行動人工智慧創新中心均將進駐，並持續進行人才招募與投資。</p> <p>5、COMET 中心晶片測試及封裝計畫的合作廠商包括位於高雄市的「日月光半導體製造股份有限公司」及位於台中市的「矽品精密工業股份有限公司」，高通公司已將所承諾的長期資本設備經費投資在與該二公司的合作計畫，可望對台灣中南部地區帶來正向的外溢效果及相關產業利益。</p> <p>6、高通公司已公告超過 300 個人才職缺，並聘僱 280 名人員；「台灣營運與製造工程暨測試中心」新大樓完工後將可容納 1,000 名員工。</p> <p>7、高通公司「台灣營運與製造工程暨測試中心」所建立之卓越中心及實驗室如下：</p> <p>(1)「毫米波」卓越中心：設立實驗室研究尖端 5G 技術，將技術開發與執行的重要團隊由美國加州聖地牙哥傳至台灣新竹市。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 109 年 8 月 31 日止)
		<p>(2)「生物辨識感測器」卓越中心：開始進行共聚物溶劑烘烤 (copolymer solvent baking) 與結晶過程 (the crystallization process) 實驗。</p> <p>(3)5G 射頻裝置及 5G 模組實驗室：支援台灣 8 項不同的模組產品專案，包括設計、性能調校、系統驗證及除錯。</p> <p>(4)生產測試中心與封包暨熱/機械實驗室：推出晶圓針測、最終測試及系統層級測試相關生產測試中心業務。</p>
<p>二、5G 技術與產品開發</p>	<p>(一)投資金額：約 1 億美元。</p> <p>(二)設立 5G 測試環境實驗室並提供教育訓練。</p> <p>(三)為中小企業進行 5G 教育訓練。</p>	<p>1、高通公司將採取具體行動，協助台灣 OEM 廠商針對全球市場開發 5G 智慧型手機及其他新興產品。</p> <p>2、高通公司將協助台灣行動通訊營運商，為台灣消費者進行規劃及布局 5G 行動通訊服務。</p> <p>3、高通公司已設立 5G Innovation Lab，係亞太地區具備最佳 5G 測試環境實驗室之一：</p> <p>(1) 107 年 9 月 21 日宣布 Innovation Lab 已具備 5G</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
	<p>(四) 支援台灣行動通訊營運商啟用 5G 網路。</p> <p>(五) 建立 5G 測試裝置生態系及製造環境。</p>	<p>測試能力，可提供全面 5G 測試環境，並為高通公司技術平台支援的 5G 發展專案提供關鍵資源及技術經驗，同時將為台灣無線通訊產業提供 5G 相關的教育訓練。</p> <p>(2) 5G 測試環境實驗室將提供包含中小企業在內的台灣公司，使其接觸有關全球發展趨勢、市場需求及最新規範等全球性資源及資訊；該實驗室並將協助縮短台灣公司 5G 產品之上市時間，進一步提升台灣於全球 5G 供應鏈及生態系所扮演之關鍵角色。</p> <p>(3) 已擴大升級 Qualcomm Innovation Lab-Taiwan，建置完善的 5G 測試環境，支援 67 項客戶專案，並與 28 家全球製造商及營運商進行合作。</p> <p>4、高通公司已開始進行 5G 模組先期認證支援，並與台灣測試廠商合作。</p> <p>5、高通公司已與台灣行動通訊營運商進行 5G 測試網路兼容性測試，及辦理 5G 教育訓練，協助台灣行動通訊營運商為 5G 網路上市做好準備。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 109 年 8 月 31 日止)
		<p>6、高通公司已提供模組預認證支援服務，與當地測試中心合作，為全球運算、用戶端設備及行動路由器客戶提供服務。</p> <p>7、高通公司已加入台灣 5G 產業發展聯盟，提供 5G 技術專業知識，協助加速台灣 5G 產業與價值鏈發展。</p> <p>8、高通公司已與台灣區電機電子工業同業公會 (TEEMA) 合作推出 5G 無線技術線上學習課程，以協助台灣創新中小企業在 5G 全球產業鏈中拓展商機。</p> <p>9、高通公司已與中華電信公司、日月光公司合作打造台灣首座 5G mmWave 企業專網之智慧工廠，並於 109 年 7 月 10 日召開啟動會議，共同洽商 5G 企業專網應用。</p>
<p>三、協助台灣 OEM 廠商拓展全球市場及開發新興產</p>	<p>(一)投資金額：約 5 千萬美元。</p> <p>(二)支援台灣 OEM 及 ODM 廠商開發高價值新興產品。</p>	<p>1、高通公司將支援並加速開發高價值新興產品領域(例如 AR/VR 眼鏡、智慧型穿戴裝置、搭載 ARM 的 Windows 裝置、工業物聯網、AI Camera、3D Camera 等)。</p> <p>2、高通公司將支援台灣 OEM/ODM 產品拓展全球市場： (1) AR/VR 眼鏡：Google、Facebook 及 HTC 等開發頭戴</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
品		<p>式顯示器（HMD）之領導廠商將採用高通公司晶片。</p> <p>(2) 搭載 ARM 的 Windows 裝置：高通公司為目前唯一一家矽晶供應商支援搭載 ARM 的 Windows 裝置，搭載 ARM 的 Windows 裝置將提供消費者支援完整 Windows，且可隨時上網而相當便於攜帶，有全天電力續航能力之裝置。基於台灣 OEM/ODM 廠商對於設計以 Windows 為基礎之產品的豐富經驗，其將有相當機會於上述新興市場領域之成長中獲益。</p> <p>(3) 工業物聯網：高通公司將大量投資以促進物聯網（IoT）市場，包含高通公司近期宣布的 Qualcomm 無線邊緣服務（QWES）亦將支援工業物聯網之應用。</p> <p>3、高通公司已開始提供台灣廠商有關鏡頭、顯示器、記憶體、電力、效能、散熱及先期認證實驗室服務，台灣廠商已開始在全球推出相關產品。</p> <p>4、高通公司已與台灣關鍵零組件（記憶體、顯示器及感測器）廠商進行合作及提供技術支援，並為台灣廠商共 127 名工程師辦理相關工作坊活動，持續強化台灣重要</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
		<p>零組件生態系。</p> <p>5、高通公司已協助台灣廠商於全球市場擴展與競爭，包括透過 Qualcomm Innovation Lab-Taiwan，提供超過 200 項智慧型手機開發與預認證實驗室服務，提供客戶超過 4 萬 7 千服務小時，並協助超過 140 項台灣廠商產品於全球上市。</p>
<p>四、在臺灣進行研發新創及生態系發展</p>	<p>(一)投資金額：約 5 千萬美元。</p> <p>(二)設立「多媒體研發中心」、「行動人工智慧創新中心」及「CPU 設計研發中心」。</p> <p>(三)舉辦「高通台灣研發合作計畫」，提供學校研發經費。</p>	<p>1、107 年 9 月 26 日宣布成立「多媒體研發中心」與「行動人工智慧創新中心」。「多媒體研發中心」將聚焦於 3D 感測、3D 人臉偵測及辨識技術、AR/VR 等相關技術。「行動人工智慧創新中心」將著重於終端裝置的 AI 平台及應用研究，並將借助台灣中小企業及 OEM/ODM 廠商對產品設計的能力與開發經驗，共同拓展智慧型手機及物聯網終端裝置上的 AI 應用。</p> <p>2、108 年 3 月 28 日宣布啟動「高通台灣研發合作計畫」，將與大專院校在無線通訊、機器學習與人工智慧、及多媒體等 3 項尖端科技領域進行合作研究，以培育台灣年</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
	<p>(四)舉辦「高通台灣創新競賽」，提供新創團隊獎金及育成資源。</p>	<p>輕人才並提升台灣創新生態系。</p> <p>3、108 年 4 月 8 日宣布舉辦「高通台灣創新競賽」，將透過發掘及育成具創新性的中小企業與產品，協助支持台灣資通訊產業生態系成長。此競賽將與科技部合作，鼓勵新創團隊於 5G、物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發新興產品。</p> <p>4、108 年 4 月 22 日至 5 月 17 日於台南、台中、新竹、桃園及台北等地舉辦「高通台灣創新競賽」巡迴說明會，向中小企業、新創公司及個人進行徵件說明及提問交流，入圍團隊將獲 1 萬美元獎金，總獎金高達 30 萬美元。</p> <p>5、高通公司已與台灣 14 所大學簽約研究合作計畫，提供研發經費，並於 108 年 5 月 29 日在台北國際電腦展（COMPUTEX）與其中 4 所頂尖大學（臺灣大學、清華大學、交通大學及成功大學）進行簽約儀式。高通公司同時亦支持 COMPUTEX 創新與新創展區（InnoVEX）之新創競賽，鼓勵台灣創新生態系。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
		<p>6、108 年 7 月 19 日高通公司公布「高通台灣創新競賽」（QITC）10 支新創團隊入選名單，各隊除獲得 1 萬美元入圍獎金外，並將開展為期 6 個月的育成計畫。</p> <p>7、108 年 7 月 29 日及同年 9 月 27 日高通公司為「高通台灣創新競賽」（QITC）新創團隊辦理智慧財產權教育訓練課程。</p> <p>8、108 年 11 月 14 日至 16 日高通公司參與 Meet Taipei 創新創業嘉年華活動。</p> <p>9、108 年 12 月 10 日科技部、高通公司及 Techstars 新創加速器共同開設「新創生態圈經營計畫」合作啟動記者會，加強台灣新創與國際間的連結。</p> <p>10、108 年 12 月 17 日高通公司辦理「高通台灣創新競賽」（QITC）決賽及成果發表活動，提供入圍及獲獎團隊總計超過 40 萬美元的獎金，協助其業務發展。</p> <p>11、108 年 12 月 18 日高通公司與 14 所大學辦理第 1 屆高通台灣研發合作成果發表會，共同進行超過 25 項研究計畫專案。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
		<p>12、高通公司規劃於 109 年成立 CPU 設計研發中心，持續擴展在台灣的研發量能。</p> <p>13、109 年 2 月 13 日高通公司宣布舉辦第 2 屆「高通台灣創新競賽」，將提供入圍團隊獎金、輔導協助及工程資源等，並將辦理相關工作坊及培訓課程。</p> <p>14、109 年 3 月 9 日高通公司宣布啟用「高通台灣創新中心」(Qualcomm Innovation Center, Taiwan)，作為高通台灣創新競賽基地，配備先進儀器設備，可迅速進行產品原型設計及互通性測試，提供諮詢及技術支援服務，同時擁有供會議、知識交流及培訓使用的工作空間。</p> <p>15、109 年 3 月 29 日高通公司宣布入圍第 1 屆「高通台灣創新競賽」的 2 家新創公司，獲邀成為高通公司全球商用生態系的成員。</p> <p>16、109 年 5 月 14 日高通公司宣布第 2 屆「高通台灣創新競賽」入圍名單，由運用 5G、物聯網、機器學習等科技，以開發 XR、智慧農業、智慧醫療、智慧工業、智</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 109 年 8 月 31 日止）
		<p>慧城市等相關應用為主的 10 支新創團隊獲選，各隊除將獲得 1 萬美元入圍獎金外，並將開展為期 6 個月的育成計畫。</p> <p>17、109 年 5 月 26 日至 27 日、6 月 10 日、7 月 8 日、8 月 5 日高通公司已為「高通台灣創新競賽」入圍團隊辦理商業輔導及智慧財產權教育訓練等課程。</p> <p>18、109 年 6 月 17 至 19 日及同年 7 月 15 至 17 日高通公司已與台北市電腦商業同業公會（TCA）共同辦理人工智慧 AI 教育訓練課程，共計有 70 名人員參與。</p> <p>19、109 年 6 月 18 日高通公司已與 10 所大學簽訂合作計畫；共計合作 32 項計畫及 36 項研究主題，研究領域涵蓋 5G、AI、IoT、機器學習、影像視覺等。</p>